

DDP

Papel presspan diamantado con resina epoxi en estado B

Composición: Papel pressphan 3055 impreso por ambas caras con rombos de resina epoxi en estado B, uniéndose y formando un sistema de aislamiento de excelente estabilidad una vez calentado en transformadores de aceite. La resina es aplicada formando cuadrados de 9,5 mm de lado dispuestos formando un diamante.

Aplicaciones: Utilizando el **DDP**, las distintas capas del bobinado quedan unidas consiguiendo que toda la bobina se convierta en un bloque sólido.

La resistencia a los cortocircuitos de dichos bobinados se incrementa considerablemente comparados con los sistemas convencionales. Se consigue un gran ahorro debido a la reducción de los elementos de soporte.

La alta resistencia a la tracción y elasticidad del **DDP** hace posible su uso en procesos de bobinado automáticos.

Propiedades: El **DDP** puede ser utilizado para la unión entre sí de las distintas capas de cobre o aluminio, capas de aislamiento, laminaciones y tiras.

La distribución de los puntos de resina en estado B asegura un espacio suficiente entre ellos para facilitar la impregnación del aceite.

El **DDP** puede ser aplicado en una o más capas entre las partes a aislar. Mediante calentamiento en un horno de secado y presión, la fina capa de resina en estado B, funde y polimeriza. A través de este proceso las capas quedan pegadas entre ellas (ver gráfico).

Suministro:

Espesores standard: **0,13 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 mm**

Espesores no standard: **0,10 - 0,38 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 1 mm**

En bobinas ancho máximo: **1600 mm**

Diámetro interior: **76 mm**

Diámetro exterior max.: **400 mm**

Disponible en rollos cortados a partir de **10 mm**

Características Técnicas:

Propiedades	Unidad	Norma	Valores						
			0,13	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
Esesor			0,13	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
Espesor base del PSP 3055 (sin recubrimiento)	µm	CEI 641-2	125	150	200	250	300	400	500
Espesor del recubrimiento de resina	µm	CEI 641-2	20 - 40						
Espesor final del DD-preg 1110 (con recubrimiento)	µm	CEI 641-2	155	180	230	280	330	430	530
Tolerancia sobre espesor total	mm	-	± 0,02						
Peso específico aparente de PSP 3055 base	g/cm ³	CEI 641-2	1,2 - 1,25						
Gramaje base del PSP 3055 (sin recubrimiento)	g/cm ²	CEI 641-2	150	180	240	300	360	480	600
Gramaje final del DD-preg 1110 (con recubrimiento)	g/cm ²	CEI 641-2	160	190	250	310	370	490	610
Resistencia a la tracción MD TD	N/mm ² N/mm ²	CEI 641-2	80 a 120 50 a 70						
Elongación a la rotura MD TD	% %	CEI 641-2	> 6 > 8						
Retracción tras el secado MD TD	% %	CEI 641-2	< 0.6 < 0.6						
pH de extracto acuoso	-	CEI 641-2	6 a 8						
Conductividad del extracto acuoso	µS/m	CEI 554	2 a 4						
Contenido de cenizas	%	CEI 641-2	< 0,5						
Contenido de humedad	%	CEI 641-2	6 a 8						
Rigidez dieléctrica en aire	kV	CEI 243-1	1,3	1,95	2,6	3	3,3	4	4,5
Rigidez dieléctrica en aceite	kV	CEI 243-1	9,9	12	16	18	21	25,6	29

Ciclo de curado: (en ° C)

Gráfica de curado del papel DD-preg 1110

